



# AUS Series

## アルカリ現像型パッケージ用ソルダーレジスト

Photoimageable Solder Resist for Package Substrate

**PHOTOFINER**  
フォトファイナー

**New Product**

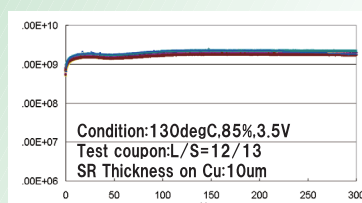
### Liquid Type Solder Resist AUS AZ1 for FC-xGA

#### 特徴 Features

- 高クラック耐性 (Excellent TCT resistance)
- 高 HAST 特性 (Excellent HAST resistance)
- 薄膜対応 (Excellent reliability with thin coating)
- 優れた塗膜物性 (Excellent property)
- フィルムタイプ (AUS AZ1-F) もリリース予定



Machine:Projection Type



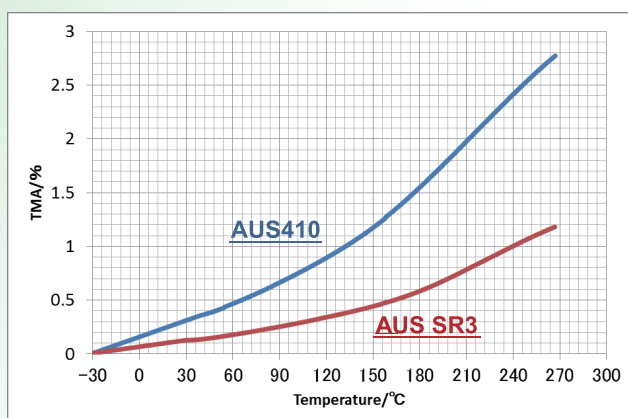
#### 特性 Properties

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| ガラス転移点 Tg *TMA method                    | 150-160°C      |
| 線膨張係数 CTE ( $\alpha$ 1)                  | < 30ppm        |
| 弾性率 Young's modulus                      | 5.0-6.0 GPa    |
| 破壊強度 Tensile strength                    | 90-100 MPa     |
| 破壊伸び率 Elongation                         | 4.0-5.0%       |
| HAST 耐性 (130°C/85%RH,3.5V)               | 300h Pass      |
| 冷熱サイクル耐性 (150°C $\leftrightarrow$ -65°C) | 1000cycle Pass |

### Dry Film Type Solder Resist AUS SR3 for FC-CSP, Memory

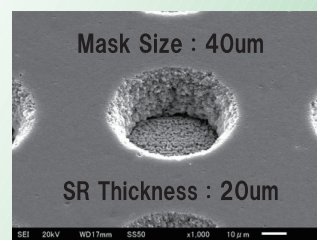
#### 特徴 Features

- 高 Tg / 低 CTE (High Tg /Low CTE )
- 高弾性率 / 高強度 (High modulus & strength)
- 優れた HAST 耐性 (High HAST resistance)



#### 特性 Properties

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| ガラス転移点 Tg *TMA method      | 150-175°C  |
| 線膨張係数 CTE ( $\alpha$ 1)    | 15-20 ppm  |
| 弾性率 Young's modulus        | > 10.0 GPa |
| 破壊強度 Tensile strength      | 90-100MPa  |
| 破壊伸び率 Elongation           | > 3.0%     |
| HAST 耐性 (130°C/85%RH,3.5V) | 300h Pass  |



Machine:DI Type